

2023年5月吉日

お客様各位



「SEMICON China 2023」出展のご案内

拝 啓

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

芝浦メカトロニクスは、6月29日（木）～7月1日（土）『SEMICON China 2023』に出展いたします。

芝浦メカトロニクスグループは、長年培ってきたコア技術（精密メカトロニクス、洗浄、ボンディング、エッチング、真空、成膜など）を結集して、半導体、電子部品、フラットパネルディスプレイなどの用途向けに製造装置の開発からアフターサービスまでトータルソリューションを提供しています。

お客様の多種多様なご要望にお応えできる商品ラインナップをご紹介しますので、

是非この機会に、芝浦メカトロニクスの新しい技術をご覧いただきたく、ご来場をお待ち申し上げます。

敬 具

－ 記 －

日 時：2023年6月29日（木） 9:00～17:00
30日（金） 9:00～17:00
7月 1日（土） 9:00～16:00
会 場：Shanghai New International Expo Centre
（上海市浦東新区龍陽路2345号）

SEMICON®
CHINA

展示ブース：Hall E1 1427

出 展 品 目： パネル展示

1) 半導体前工程

- ・枚葉式ウェーハ洗浄装置 SC300-CC series/ FC series
- ・高温リン酸エッチング装置 SC300-HT series
- ・等方性エッチング装置 CDE series
- ・フォトマスク洗浄装置 MC150 series
- ・フォトマスクエッチング装置 ARES series
- ・フォトマスクアッシング装置 RPA series

2) 半導体後工程

- ・高精度ボンダ ラインナップ
- ・マルチプロセス高精度ボンダ TFC-6500
- ・FO-PLPボンダ TFC-9300
- ・LCD/OLED用COFボンダ TFC-3600

SEMICON China 公式サイト：<https://www.semiconchina.org/>

【お問い合わせ先】

芝浦メカトロニクス株式会社

e-mail：

webサイト：<https://www.shibaura.co.jp/>